2017-2022年中国半导体封装市场运行态势及投资战略研究报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2017-2022年中国半导体封装市场运行态势及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/201611/464303.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。封装过程为：来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片（Die），然后将切割好的晶片用胶水贴装到相应的基板（引线框架）架的小岛上，再利用超细的金属（金锡铜铝）导线或者导电性树脂将晶片的接合焊盘（BondPad）连接到基板的相应引脚（Lead），并构成所要求的电路；然后再对独立的晶片用塑料外壳加以封装保护，塑封之后还要进行一系列操作，封装完成后进行成品测试，通常经过入检Incoming、测试Test和包装Packing等工序，最后入库出货。

智研咨询发布的《2017-2022年中国半导体封装市场运行态势及投资战略研究报告》共十二章。首先介绍了半导体封装产业相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体封装行业规模及消费需求，然后对中国半导体封装行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体封装行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体封装行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 2013-2016年世界半导体封装行业发展态势分析 14
第一节 2013-2016年世界半导体封装市场发展状况分析 14
一、世界半导体封装行业特点分析 14
二、世界半导体封装市场需求分析 14
第二节 2013-2016年影响世界半导体封装发展因素分析 15
第三节 2017-2022年世界半导体封装市场发展趋势分析 15

第二章 中国半导体封装行业发展环境 17
第一节 2016年中国宏观经济运行回顾 17
一、国内生产总值 17

2015年，我国国民经济稳定增长。初步核算，全年国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值60863亿元，增长3.9%；第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.0%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为50.5%，首次突破50%。2015年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，稳中求进成为2015年的工作总基调，中国进入以提高质量效益为中心，调整产业结构，深化改革开放的发展

阶段。
2011- 2016年中国国内生产总值及其增长速度
二、社会消费 19
2015 年中国社会消费品零售总额为300931 亿元，同比名义增长10.7%（扣除价格因素，实际增长10.6%），我国居民人均可支配收入2015年达到21996元，同比增长7.4%，超过GDP增速，为居民消费需求和消费支出增长提供了事实上的基础。
2011-2015年我国社会消费品零售总额
三、固定资产投资 20
四、对外贸易 21
第二节 2016年中国宏观经济发展趋势 22
第三节 2016年半导体封装行业相关政策及影响 24
一、行业具体政策 24
二、政策特点与影响 26
(一)全球市场形势不容乐观 26
(二)国内行业形势严峻 26
(三)国内政策环境不断改善 27

第三章 中国半导体封装行业发展特点 28
第一节 2013-2016年半导体封装行业运行分析 28
第二节 中国半导体封装产业特征与行业重要性 29
一、在第二产业中的地位 29
二、在GDP中的地位 29
第三节 半导体封装行业特性分析 30
一、投资风险庞大 30
二、相关人才相对缺乏 30
三、当地晶圆制造能力薄弱 31
第四节 半导体封装行业发展历程 31
第五节 半导体封装行业技术现状 31
一、注重新事物新技术的应用 32
二、实施标准化的优势 32
三、新型封装技术的应用 33
四、无铅焊接技术的采纳 33
五、关注倒装芯片技术的发展 33
六、集成电路封装技术国家工程实验室启动 34
第六节 国内外市场的重要动态 35

一、封装材料销售额稳步增长 35
二、新技术推动材料产业发展 36

第四章 中国半导体封装行业运行情况 38
第一节 企业数量结构分析 38
第二节 行业生产规模分析 38
第三节 行业发展集中度 39
第四节 2016年半导体封装行业景气状况分析 41
一、2016年半导体封装行业景气情况分析 41
二、行业发展面临的问题及应对策略 41
三、国际市场发展趋势 41
(一)封装形式向轻、薄、短、小发展 41
(二)封装技术日新月异 42
四、国际主要国家发展借鉴 43

第五章 中国半导体封装行业供需情况 44
第一节 半导体封装行业市场需求分析 44
一、行业需求现状 44
二、需求影响因素分析 45
第二节 半导体封装行业供给能力分析 45
一、行业供给现状 45
二、需求供给因素分析 46

第六章 2013-2016年半导体封装行业销售状况分析 48
第一节 2013-2016年半导体封装行业销售收入分析 48
一、2014-2016年行业总销售收入分析 48
二、2014-2016年不同规模企业总销售收入分析 48
三、2014-2016年不同所有制企业总销售收入比较 49
第二节 2014-2016年半导体封装行业投资收益率分析 50
一、2014-2016年按销售成本率分析 50
二、2014-2016年按销售费用率分析 51
第三节 2016年半导体封装行业产品销售集中度分析 52
第四节 2014-2016年半导体封装行业销售税金分析 53
一、2014-2016年行业销售税金分析 53
二、2014-2016年不同规模企业销售税金分析 53

三、2014-2016年不同所有制企业销售税金比较 54
第七章 2013-2016年半导体封装行业进出口分析 56
第一节 半导体封装历史出口总体分析 56
第二节 影响半导体封装进出口的主要因素 56
一、半导体封装产品的国内外市场需求态势 56
二、国内外半导体封装产品的比较优势 57
三、半导体封装贸易环境的影响 57
第三节 我国半导体封装出口量预测 57

第八章 中国半导体封装行业重点区域运行分析 59
第一节 2014-2016年华东地区半导体封装行业运行情况 59
一、华东地区半导体封装行业产销分析 59
二、华东地区半导体封装行业盈利能力分析 59
三、华东地区半导体封装行业偿债能力分析 60
四、华东地区半导体封装行业营运能力分析 61
第二节 2014-2016年华南地区半导体封装行业运行情况 62
一、华南地区半导体封装行业产销分析 62
二、华南地区半导体封装行业盈利能力分析 63
三、华南地区半导体封装行业偿债能力分析 63
四、华南地区半导体封装行业营运能力分析 64
第三节 2014-2016年华中地区半导体封装行业运行情况 65
一、华中地区半导体封装行业产销分析 65
二、华中地区半导体封装行业盈利能力分析 66
三、华中地区半导体封装行业偿债能力分析 66
四、华中地区半导体封装行业营运能力分析 67
第四节 2014-2016年华北地区半导体封装行业运行情况 68
一、华北地区半导体封装行业产销分析 68
二、华北地区半导体封装行业盈利能力分析 69
三、华北地区半导体封装行业偿债能力分析 69
四、华北地区半导体封装行业营运能力分析 70
第五节 2014-2016年西北地区半导体封装行业运行情况 71
一、西北地区半导体封装行业产销分析 71
二、西北地区半导体封装行业盈利能力分析 72
三、西北地区半导体封装行业偿债能力分析 72
四、西北地区半导体封装行业营运能力分析 73

第六节 2014-2016年西南地区半导体封装行业运行情况 74
一、西南地区半导体封装行业产销分析 74
二、西南地区半导体封装行业盈利能力分析 75
三、西南地区半导体封装行业偿债能力分析 75
四、西南地区半导体封装行业营运能力分析 76
第七节 2014-2016年东北地区半导体封装行业运行情况 77
一、东北地区半导体封装行业产销分析 77
二、东北地区半导体封装行业盈利能力分析 78
三、东北地区半导体封装行业偿债能力分析 78
四、东北地区半导体封装行业营运能力分析 79
第九章 中国半导体封装行业SWOT 分析 81
第一节 半导体封装行业发展优势分析 81
第二节 半导体封装行业发展劣势分析 81
第三节 半导体封装行业发展机会分析 82
第四节 半导体封装行业发展风险分析 82
第十章 半导体封装行业重点企业竞争分析 84
第一节 奇梦达科技(苏州)有限公司 84
一、企业概况 84
二、竞争优势分析 84
三、2014-2016年经营状况 84
(一)企业偿债能力分析 84
(二)企业运营能力分析 87
(三)企业盈利能力分析 90
四、2017-2022年发展战略 93
第二节 江苏新潮科技集团有限公司 93
一、企业概况 93
二、竞争优势分析 94
三、2014-2016年经营状况 94
(一)企业偿债能力分析 94
(二)企业运营能力分析 97
(三)企业盈利能力分析 100
四、2017-2022年发展战略 103
第三节 南通华达微电子集团有限公司 103
一、企业概况 103
二、竞争优势分析 103

三、2014-2016年经营状况 104
(一)企业偿债能力分析 104
(二)企业运营能力分析 107
(三)企业盈利能力分析 110
四、2017-2022年发展战略 113
第四节 英飞凌科技(苏州)有限公司 113
一、企业概况 113
二、竞争优势分析 114
三、2014-2016年经营状况 114
(一)企业偿债能力分析 114
(二)企业运营能力分析 117
(三)企业盈利能力分析 120
四、2017-2022年发展战略 123
第五节 深圳赛意法微电子有限公司 123
一、企业概况 123
二、竞争优势分析 124
三、2014-2016年经营状况 124
(一)企业偿债能力分析 124
(二)企业运营能力分析 126
(三)企业盈利能力分析 129
四、2017-2022年发展战略 132
第十一章 未来半导体封装行业发展预测 133
第一节 2017-2022年国际市场预测 133
一、2017-2022年半导体封装行业产能预测 133
二、2017-2022年全球半导体封装行业市场需求前景 134
三、2017-2022年全球半导体封装行业市场价格预测 135
第二节 2017-2022年国内市场预测 136
一、2017-2022年半导体封装行业产能预测 136
二、2017-2022年国内半导体封装行业产量预测 138
三、2017-2022年全球半导体封装行业市场需求前景 138
四、2017-2022年国内半导体封装行业市场价格预测 139
五、2017-2022年国内半导体封装行业集中度预测 140

第十二章 半导体封装行业投资战略研究 142（ZY CW）
第一节 半导体封装行业发展战略研究 142

一、战略综合规划 142
二、技术开发战略 145
三、业务组合战略 149
四、区域战略规划 150
五、产业战略规划 150
六、营销品牌战略 152
七、竞争战略规划 152
第二节 对中国半导体封装行业品牌的战略思考 154
一、企业品牌的重要性 154
二、半导体封装行业实施品牌战略的意义 154
三、半导体封装行业企业品牌的现状分析 155
四、半导体封装行业企业的品牌战略 157
(一)要树立强烈的品牌战略意识 157
(二)选准市场定位，确定战略品牌 158
(三)运用资本经营，加快开发速度 158
(四)利用信息网，实施组合经营 158
(五)实施规模化、集约化经营 159
五、半导体封装行业品牌战略管理的策略 159
第三节 半导体封装行业投资战略研究 160
一、2016年半导体封装行业投资战略 160
二、2017-2022年半导体封装行业投资战略 161
图表目录：
图表 1 国内生产总值季度累计同比增长率(%) 19
图表 2 工业增加值月度同比增长率(%) 20
图表 3 社会消费品零售总额月度同比增长率(%) 21
图表 4 固定资产投资完成额月度累计同比增长率(%) 23
图表 5 出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率(%) 24
图表 6 2016年半导体封装行业在第二产业中所占的地位 31
图表 7 2016年半导体封装行业在GDP中所占的地位 31
图表 8 2014-2016年世界半导体封装材料市场规模及增长对比图 37
图表 9 2014-2016年我国半导体封装行业销售收入对比图 40
图表 10 国内封装测试企业地域分布情况 41
图表 11 2016年十大封装测试企业 41
图表 12 2014-2016年我国IC产量及增长对比图 46
图表 13 中国集成电路各产业链产值比重 47

图表 14 2014-2016年我国半导体封装行业销售收入 49
图表 15 2014-2016年我国半导体封装行业不同规模企业销售收入(亿元) 49
图表 16 2014年底我国半导体封装行业不同规模企业销售收入分布图 49
图表 17 2014-2016年我国半导体封装行业不同所有制企业销售收入(亿元) 50
图表 18 2014年底我国半导体封装行业不同所有制企业销售收入分布图 50
图表 19 2014-2016年我国半导体封装行业销售成本率 51
图表 20 2014-2016年我国半导体封装行业规模企业销售成本率增长趋势图 51
图表 21 2014-2016年我国半导体封装行业销售费用率 52
图表 22 2014-2016年我国半导体封装行业规模企业销售费用率增长趋势图 52
图表 23 2016年中国重点地区半导体封装行业销售集中度情况 53
图表 24 2014-2016年我国半导体封装行业销售税金 54
图表 25 2014-2016年我国半导体封装行业规模企业销售税金增长趋势图 54
图表 26 2014-2016年我国半导体封装行业不同规模企业销售税金(亿元) 55
图表 27 2016年我国半导体封装行业不同规模企业销售税金分布图 55
图表 28 2014-2016年我国半导体封装行业不同所有制企业销售税金(亿元) 55
图表 29 2016年我国半导体封装行业不同所有制企业销售税金分布图 56
图表 30 2014-2016年我国半导体封装出口量及增长对比图 57
图表 31 2017-2022年我国半导体封装出口量预测图 58
图表 32 2014-2016年华东地区半导体封装行业盈利能力对比图 60
更多图表见正文……

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/201611/464303.html